

纳米激光高中低温针筒锡膏，定制锡膏

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 纳米激光高中低温针筒锡膏，定制锡膏 |
| 公司名称 | 广东吉田供应链管理有限公司 |
| 价格 | 10.00/克 |
| 规格参数 | 型号:YT-688T SD-5 合金成分:Sn96.5Ag3.0Cu 颗粒度:25-45 μ m.20-3 |
| 公司地址 | 广东省东莞市松山湖园区科技十路5号15栋2单元301室（注册地址） |
| 联系电话 | 13592756473 |

产品详情

一、系列产品简介

SD-588T是本公司生产的一款无铅免清洗锡膏,使用锡银铜(Sn96.5Ag3.0Cu0.5)

无铅合金焊粉及特殊溶剂,适合于要求较高温度的焊接工艺。电子业用这些无铅

合金代替普通的含铅焊料,能够有效保护地球环境。这种焊膏的印刷性能一致、

重复性好,在模板上的保质期长,适合目前的高速生产和高精密度表面贴装生产

线上使用,如手机、电脑、MID等。这种焊膏在无铅金属化表面.上的湿润性极好,

可靠性高。

优点

A.使用无铅Sn96.5Ag3.0Cu0.5合金锡粉,适用于焊接要求高的精密器件的贴装。

B.在各类型元件上均有良好的可焊性,适当的润湿性,且BGA空洞率低。

C.热塌性好,无锡珠、连锡焊接缺陷,残留物极少且呈透明状,免清洗。

D.在连续印刷及叉型模式中可获得良好的印刷效果。

E.在精密PCB板组装时,4-6#粉(5-38mm)可以满足0.3mm间距以下的印刷及焊接要求。三、产品特性

表2.产品特性

项目特性测试方法

混合物成分Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 JIS Z 3282(1999)

熔点21790根据DSC测量法

锡粉之粒径大小25- 45 μ m、 20- 38 μ m IPC-TYPE 3&4

锡粒之形状球形Annex1toJISZ3284(1994)

溶剂含量11+0.5% JIS Z 3284 (1994)

含氮溴量RAM级低卤素JIS Z 3197(1999)

粘度150+20Pa's Annex 6 to JIS Z 3284(1994)